

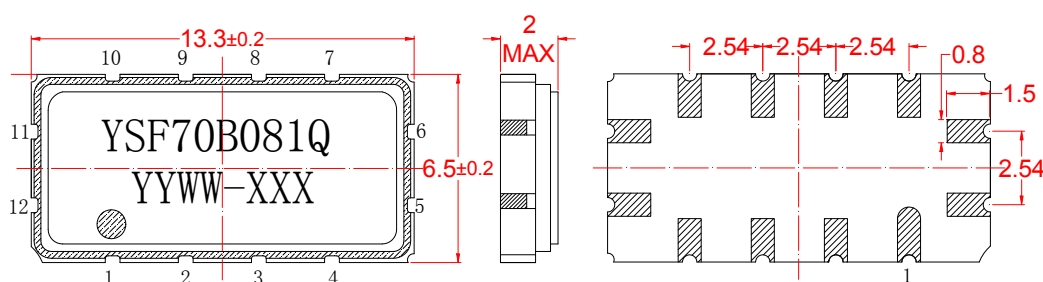
**特点:**

- 中心频率: 70MHz
- -1.5dB 带宽: 典型值 0.75MHz
- 插入损耗: 典型值 10dB
- 阻带抑制:  $f_0 \pm 1.3\text{MHz} \geq 30\text{dB}$
- SMD 封装
- 尺寸:  $13.3 \times 6.5 \times 2.0$  (max) mm

**图片:**
**性能参数: (50Ω系统,  $T_A = -55 \sim +85^\circ\text{C}$ )**

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	$f_0$		70			MHz	标称值
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ , $f=70\text{MHz}$		10	11	dB	
-1.5dB 带宽	$BW_{-1.5\text{dB}}$		0.65	0.75	0.9	MHz	
-30dB 带宽	$BW_{-30\text{dB}}$			2.3	2.5	MHz	
矩形系数	SF	$BW_{-30\text{dB}} / BW_{-1.5\text{dB}}$		3.0	3.2		
带内波动 <sup>①</sup>	BR	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f=69.75 \sim 70.25\text{MHz}$		0.5	1.0		
带内时延	$\tau$			1.7	2	us	
带内时延波动	$\Delta\tau$			0.2	0.5	us	
阻带抑制	SS <sub>1</sub>	$P_{IN}=0\text{dBm}$ , $f=1 \sim 68.7\text{MHz}$	30	45		dB	
	SS <sub>2</sub>	$P_{IN}=0\text{dBm}$ , $f=71.3 \sim 500\text{MHz}$	30	45		dB	
质量	m			0.5	2.0	g	

①带内波动: 通带范围内相邻的波峰和波谷之差的最大值, 不含边缘滚降。

**外形尺寸图:**


注: 1、未标注公差按 GB/T1804-2000 规定, 公差等级 f;

2、产品本体采用氧化铝陶瓷金属封装, 引脚及底部焊盘表面镀镍金 (Ni 1.3~8.9um, Au0.3~5.7um);

3、产品标识采用激光刻字, 盖板和底座进行平行缝焊处理;

**字符标志:**

标识	说明	备注
YSF70B081Q	产品型号	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

**引脚定义:**

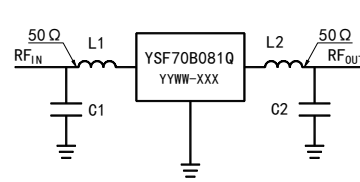
接口标识	接口说明	备注
11	输入	
5	输出	
1/2/3/4/6/7/8/9/10/12	GND	

### 极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+20dBm
装配温度	+230℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+100℃

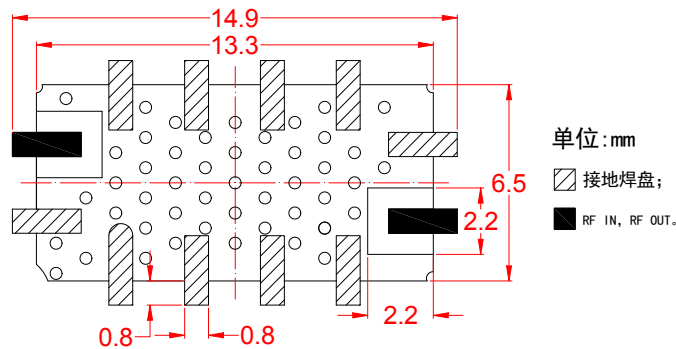
超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

### 推荐应用电路



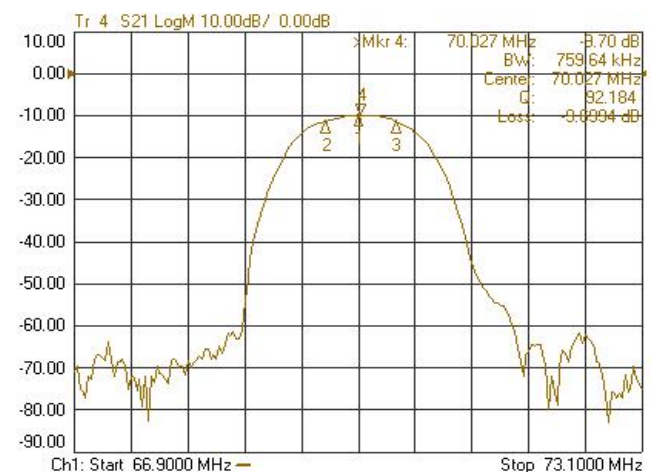
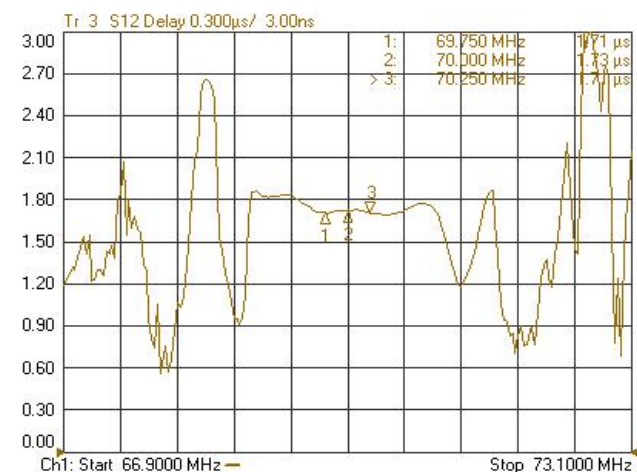
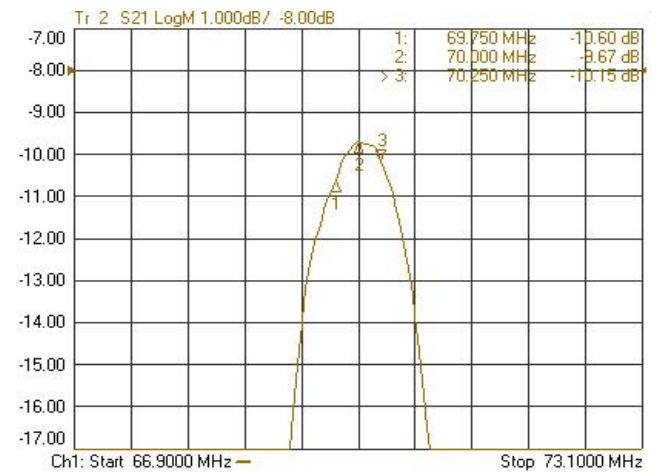
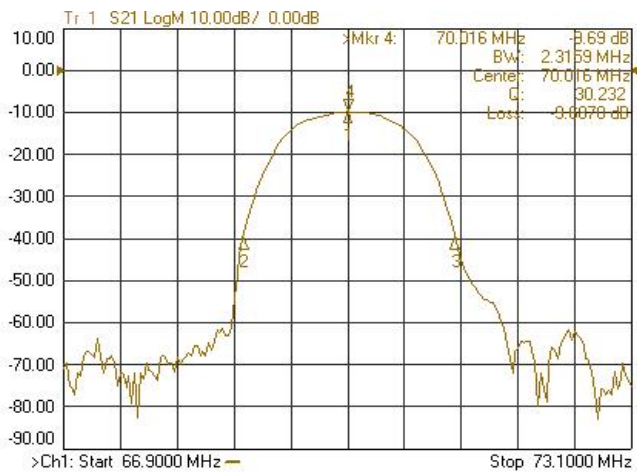
位号	值/推荐型号	备注
L1	82nH LQW18AN82NG00	
L2	82nH LQW18AN82NG00	
C1	91pF GRM1885C1H910JA01D	
C2	91pF GRM1885C1H910JA01D	

### 推荐焊盘:

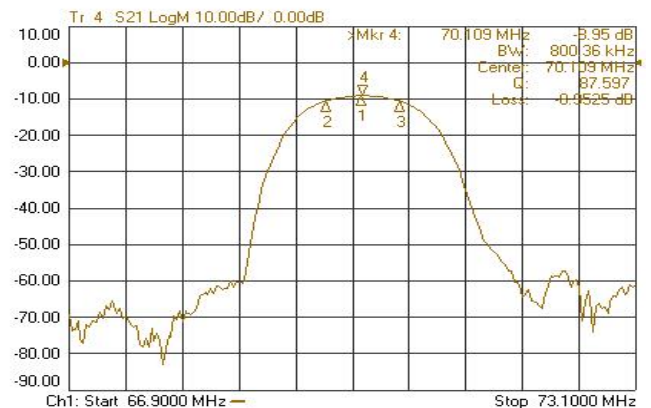
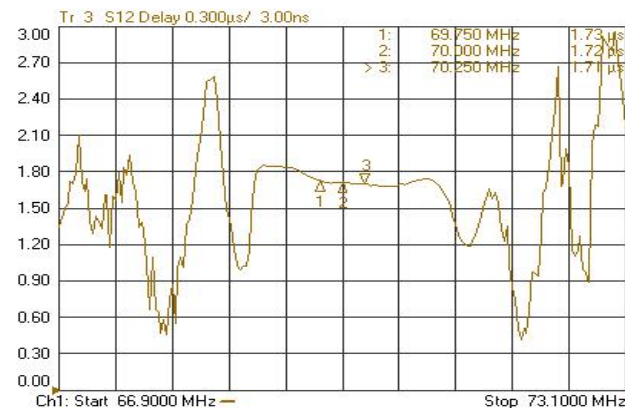
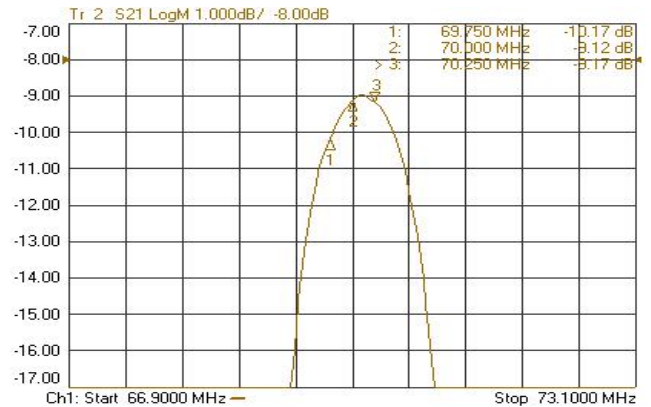


### 典型测试曲线:

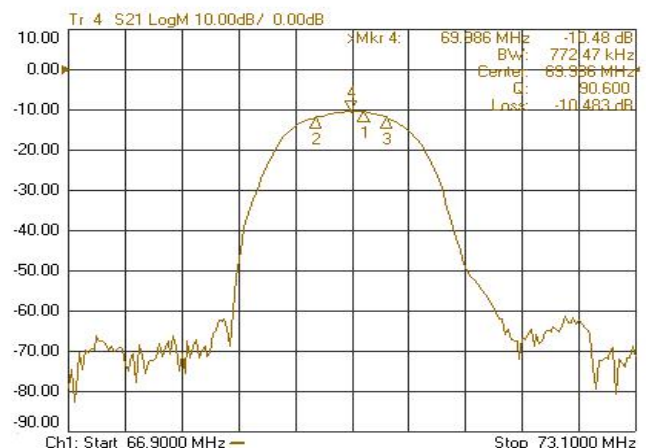
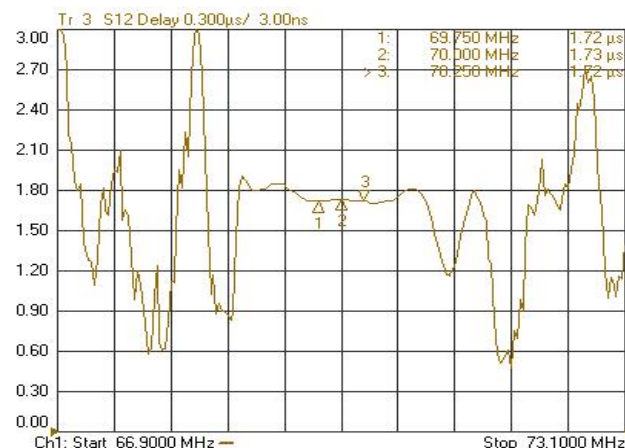
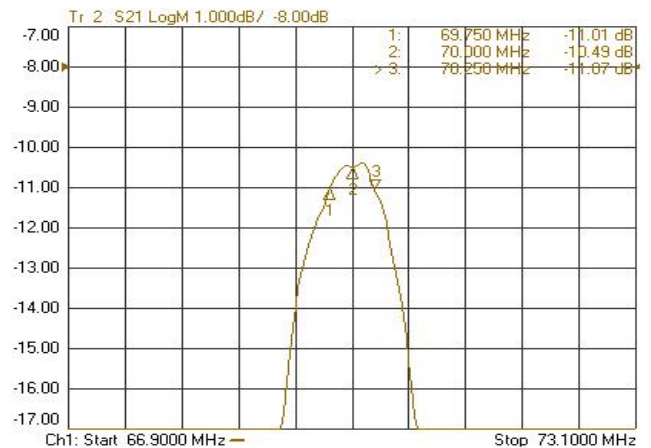
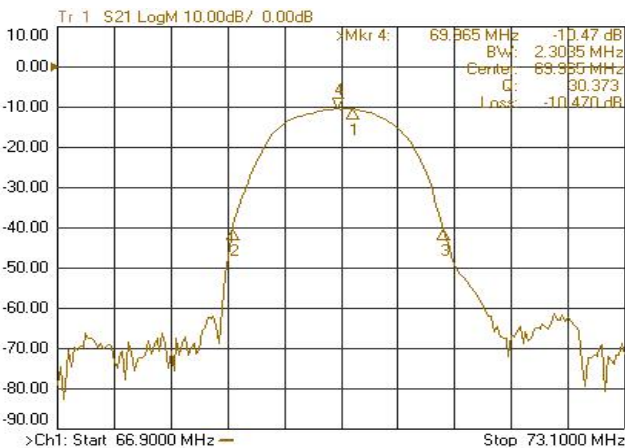
#### +25℃带内指标典型曲线



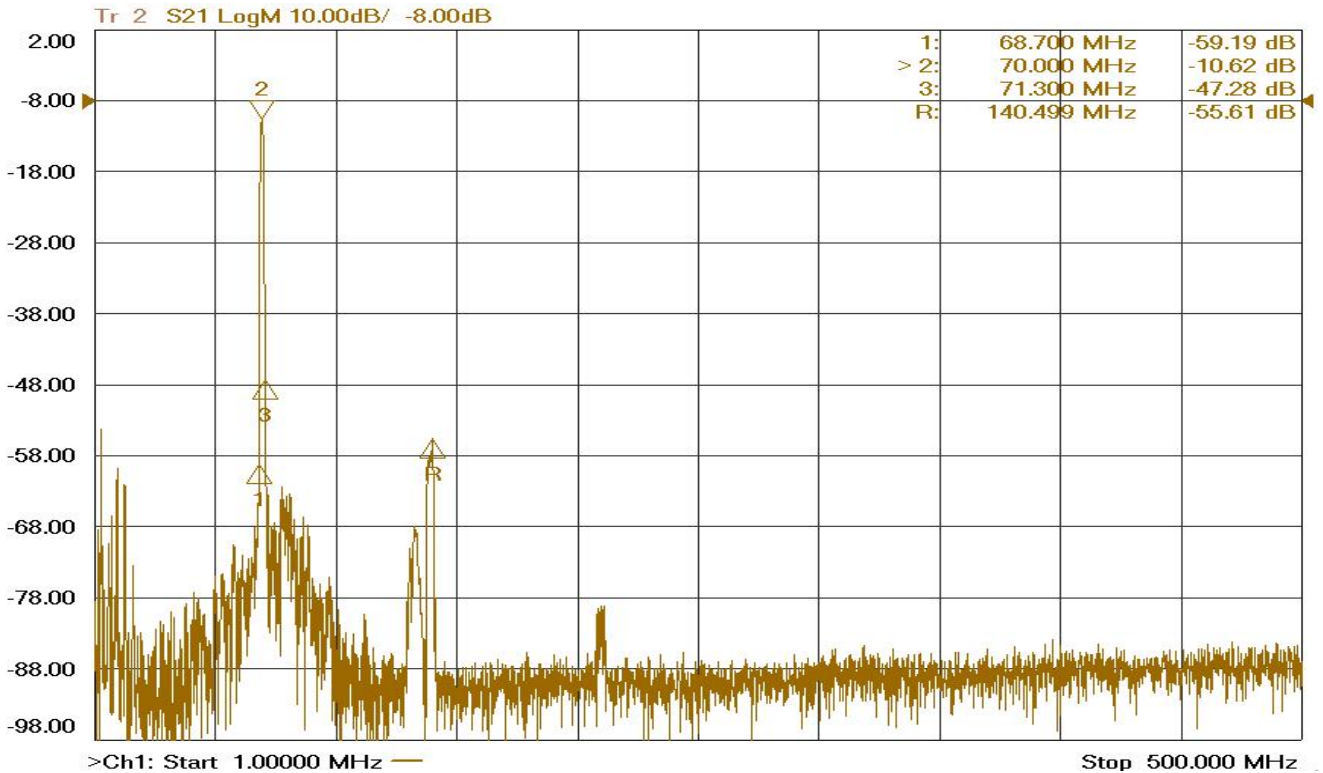
### -55°C 带内指标典型曲线



### +85°C 带内指标典型曲线

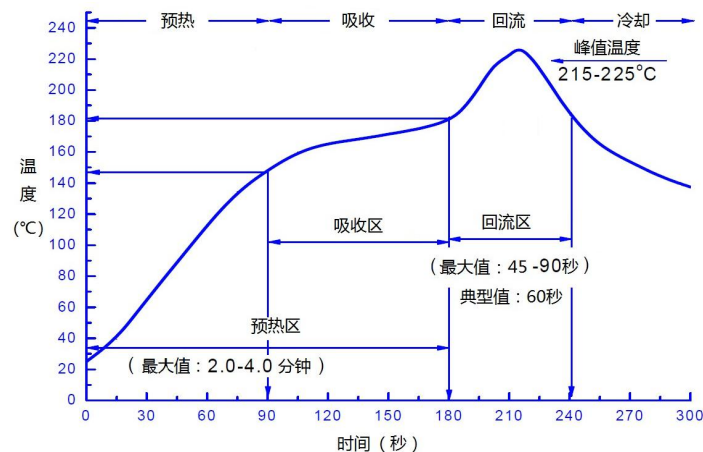


## 带外抑制典型曲线



## 产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点+183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中的装配温度。

4. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。